证券代码：688981 **证券简称：中芯国际**

中芯国际集成电路制造有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 √ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（ ）
参与单位名称	华泰证券、中信证券、东方证券、国泰海通证券、中信里昂证券、国海证券及通过电话和网络参加会议的各界人士。根据业绩说明会平台统计，电话拨入和平台连接合计共有608位投资者。
时间	2026 年 11 月 13 日
地点	网络/电话会议
公司接待人员姓名	联合首席执行官赵海军博士、资深副总裁兼董事会秘书郭光莉女士、资深副总裁兼财务负责人吴俊峰博士
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	中芯国际（证券代码：00981.HK/688981.SH）是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 英寸和 12 英寸晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务。 详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。
交流问答	（在此提醒各位，我们今天的表述，包括了前瞻性陈述，是对公司未来业绩的预期，而非保证，并受固有风险和不确定因素的影响。请参阅我们业绩公告中的前瞻性陈述。除非另有说明，业绩说明会的数据根据国际财务报告准则来表述，货币以美元表示。） ▪ 资深副总裁、财务负责人吴俊峰博士发言： 大家好。首先，我向大家汇报 2026 年第三季度未经审核业绩，然后给出第四季度指引。 三季度业绩如下： 销售收入为 31.90 亿美元，环比增长 6.1%。 毛利率为 29.9%，环比增长 4.6 个百分点。 经营利润为 7.10 亿美元。

	息税折旧及摊销前利润为 20.40 亿美元。息税折旧及摊销前利润率为 63.9%。 归属于本公司的应占利润为 4.28 亿美元。 关于资产负债，在三季度末: 公司总资产为 591 亿美元，其中库存资金 134 亿美元。 总负债为 204 亿美元，其中，有息负债为 149 亿美元。 总权益为 387 亿美元。 有息债务权益比为 38.5%，净债务权益比为 3.9%。 关于现金流量，在三季度: 经营活动所得现金净额为 11.82 亿美元。 投资活动所用现金净额为 21.04 亿美元。 融资活动所得现金净额为 9.10 亿美元。 关于 2026 年四季度，我们的指引如下: 销售收入预计环比上升 4%到 6%，毛利率预计在 26%到 28%之间。 以上是公司财务方面的情况。 ▪ 联合首席执行官赵海军博士发言: 大家好，欢迎参加中芯国际 2026 年三季度业绩说明会。 三季度，公司整体销售收入再创新高，达到 31.9 亿美元，环比增长 6.1%。比起三个月前，我们看到，客户对芯片提拉需求的增量速度比原先预期更快，使得三季度收入超出指引上限。从量的方面看，公司加快新产线验证、弹性调配已有产能，约当 8 英寸季度出货量首超 300 万片，环比增加 5.7%。从价的角度看，公司与客户协商的价格分批落地，产品组合持续优化，平均晶圆单价环比提升 1.8%。 接下来我们具体看三季度公司的收入分析。销售收入以地区分类看，中国、美国、欧亚占比分别为 90.8%、7.8%和 1.4%；从金额来看，中国区销售收入环比增长 7%，主要原因为中国客户需求增长速度高于公司整体需求增长速度，公司相应调配产能，满足客户需求。晶圆收入按尺寸分，十二英寸和八英寸占比平稳，分别为 79%和 21%；从金额来看，12 英寸和 8 英寸晶圆收入环比分别增长 9%和 4%，主要原因为客户需求饱满，且公司扩产以 12 英寸产线为主。 晶圆收入以应用来看，智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车收入占比分别为 14%、18%、41%、7%、19%。从绝对值来看，智能手机和消费电子环比分别下降 8%和 1%，需求仍较为疲弱；电脑与平板、工业与汽车、互联与可穿戴市场整体需求没有大的变化，但公司受益于产业链本土化切换和公司的前瞻性平台部署，相应收入分别实现 26%、26%和 18%的环比增长。举例来说，公司在工业与汽车领域全面布局 BCD 低中高电压产品，提供多样化的特色器件与工艺，最高支持 Grade 0 的车规标准，产品覆盖 BMS 模拟前端与系统基础芯片、数字隔离、隔离驱动

	和采样前端以及智能功率开关，全力满足相关客户的增量要求、特别是高附加值产品的需求。 三季度公司毛利率为 29.9%，环比增长 4.6 个百分点，主要是因为客户提拉要求紧迫，为支持客户出货，公司相应减缓了工程和研发投片，在月产能新增 2 万片折合 8 英寸标准逻辑晶圆的基础上，产能利用率提高至 97.3%，环比增加 3.6 个百分点，产出环比增加高个位数百分比，显著摊薄了单位晶圆成本，从而抵消了折旧费用环比上升 2.3%对毛利率的负向影响，带动毛利率环比改善并超出指引上限。 第四季度是行业传统淡季，但公司业绩淡季不淡。虽然手机、部分消费类订单有所走弱，但公司充分发挥多平台的调配能力，将释放出来的产能向专用存储、BCD 等高需求、高附加值产品倾斜。四季度，公司预计出货量保持稳健，产品组合变化及价格的随行就市推动平均销售单价上涨，预计收入环比增长 4%到 6%；同时我们看到，折旧、原材料等成本压力持续增加，以及四季度公司增加工程和研发投片量，使得产能利用率在扩产产能持续释放的基础上略有下降，所以给出的毛利率指引与上季度指引持平，为 26%到 28%。 根据前三个季度未经审核的财务数据，及四季度的指引中值，公司全年销售收入预计超过 120 亿美元，较去年同期增长接近三成；在折旧总额较去年增长约三成的情况下，毛利率预计在 26%左右，同比增加约 5 个百分点。同时我们也看到，全球设备供应链整体紧张，交付周期拉长，部分设备交付时间仍存在不确定性，虽不会影响今年的扩产规划落地，但可能对全年的资本开支执行带来扰动。 展望可预见的未来，行业确定性主要体现在两方面：1.人工智能需求有望拉长半导体上行周期，增长结构与周期形态随之变化；2.全产业链在地化大发展仍在持续。在此背景下，公司依托与客户的战略绑定，配合中国客户创新速度，将特色和客制化工艺优势做强。基于此，公司以客户需求为导向推进产能扩充，以高附加值优质产品组合构筑领先优势，努力稳定 EBITDA-也就是经营现金流能力,提升成本管控与运营效率，增强穿越周期的经营韧性，实现有质量、可持续的增长。 最后，我们依然要感谢客户、供应商、投资者，以及社会各界对公司的理解和大力支持。谢谢大家。 ▪ 问答环节： 问题 1：公司三季度毛利率非常强，并且超指引，我看到在收入增长的情况下成本下降了 2.2%，首先想请问成本管控的效果主要是什么原因？未来公司制造成本是否有进一步优化的空间？未来公司如何保持稳健增长，是不是更应该关注 EBITDA 指标？ 回复：我们上个季度对第三季度的毛利率指引和当前对第四季度的毛利率指引是一样的。目前看来四季度毛利率指引相比三季度实际的毛利率有所下降，主要是工厂遇到市场的季节性变化。三季度客户对产品下线和拉货的需求更加的着急，我们把工程、研发线的产能也一并用上了。但在三季度大量下单后，大家在四季度更多从年度验收、来年规划的角度考虑，进入了观望状态，结合各类假期，有一些不确定性。所以四季度的下线量可

	能会减少，也就是产能利用率略有下降；但出货端、销售收入仍然比较好。因此公司四季度的产能利用率和毛利率相较于三季度会略微增加一些负担。在生产管理上，折旧不变时，我们主要通过提升管理效率来对冲供应链涨价、客户调价及产品切换带来的影响。指导原则是看折旧占每美元收入的百分比。另外，公司资本支出较高，新产能增加会在一定程度上影响毛利率表现，当公司业务仍保持稳健成长的情况下，EBITDA 确实是更准确的观察指标。 问题 2：最近市场因为缺电对全球 AI 投资需求的可持续性的担忧有所上升。您怎么看明年全球 AI 相关需求的增长前景？如果全球 AI 需求节奏发生变化，将如何影响全球半导体代工行业的供需格局，以及公司明年的产能规划和业务结构？ 回复：我讲的是我理解的、客户对将来的一些认知，和我们自己在投资方面对将来的认知。我们对来年的看法很积极正面。第一，人工智能现在还是方兴未艾，它带来了很多新的行业，大家要提高效率，加快产品的迭代，设计能力要提高，这是一个从无到有的过程，没有存量。第二，应用端本身来说，各个区域都有自己的数据中心需求，因此，中芯国际未来的发展不会只取决于某一单一市场或单一公司的需求。大家现在比较达成一致的是 2027 年人工智能相关的制造需求是非常紧缺的，现在的情况会持续。我们是按照客户定好的规划和需求来建立产能、开发技术。所以我们未来还是会继续投资，继续建立产能，继续推动收入和各方面的成长。 问题 3：Q3 这个产能利用率提升较多，想请教连续两个季度出现这样的一个提拉加速背后的原因是什么？以及能否展望一下公司对下游各个细分应用领域和产品平台的需求情况？ 回复：在订单客户总量不缺的情况下，季节之间会有一些调整，拉货的程度不一样，因此产能利用率也会有一些不一样的变化。与季节性相比增量较强的、在淡季反而需求增加的比如：专用存储器、BCD 电源供应，工业和汽车，中高端的网通 IOT，大显示屏 LED 驱动类和指纹芯片等。但手机类、比较低端的网通 IOT 和面板类产品等需求还是比较弱的。 问题 4：三季度公司资本开支的同环比是有一些下降的，公司今年前三个季度的累积资本开支比照全年资本开支指引可能完成度会低一些，是否意味着四季度的资本开支会更集中？相应的从折旧上看，如何展望四季度以及明年折旧的增长情况？未来折旧高峰预计会落在什么时候？ 回复：今年整个行业都在扩产，对设备的需求量比较大，因此供应链设备的供应时间在不断加长，原本公司预计今年能到的设备目前可能到不了，会顺延到转年，所以今年的资本开支可能跟我们原来预测的相比，会略微少一点。四季度的折旧会继续增长，和预期一致。因为折旧在销售收入的占比没有太大变化，所以对四季度的毛利率预计影响有限。公司近几年的资本开支强度还是比较高的，明年的折旧指引还需要进一步测算，下个季度的业绩说明会再向大家汇报。 问题 5：现在整个半导体产业链各个方面都比较紧张，我们也看到原材料的价格可能也有一些向上的趋势，公司作为行业龙头，是否在抵御原材料

	成本上涨这块有自己的一些独特的优势和途径？ 回复：今年以来原材料价格的上涨是比较明显的。公司对于材料的供应商也是采用了多元化的布局、多方寻源，保障供应链安全，并通过集中采购、竞争性采购和长期协议等方式来平滑原材料价格上涨的影响。当前公司产能利用率已至高位，未来原材料价格的进一步上涨是会给我们的经营成本带来压力的。公司还是会通过体系化的管理，包括工艺改善、效率提升等降本增效措施尽量压低其对经营的成本压力。 问题 6：今年三季度研发费用环比增加比较多，过去几年的四季度研发费用好像也会高一些。请教研发费用季节性的波动的原因有哪些影响？ 回复：公司这几年的研发费用大致稳定在 8 亿到 9 亿美元之间，季度有些波动。研发费用主要包含材料、设备、维修、人工和软件等相关费用。随着季度间研发进度、费用结算的变化，会给季度研发费用带来一些波动。三季度的环比增加主要也是这个原因，四季度预计和三季度持平。 问题 7：公司的专用存储平台上半年已经涨过一波价，请问三季度的价格趋势如何？未来的供需格局、涨价持续性和天花板是怎样的情况？如果继续涨价是否会对客户需求带来影响？ 回复：专用存储器主要包括 NOR Flash 和 NAND Flash，我们是中国大陆最大的供应商。我们的基本策略是随行就市对价格进行调整，这一轮也是跟着行情一起涨，在以往的周期行业下行时也会一起降。目前 64M 以下的 NOR Flash 在市场上基本供需平衡，接下来涨价的可能性很小。但是高密度的价格还在增长。我们认为持续涨价不会抑制客户需求。存储领域中 DRAM 价格增长的倍数非常多，人工智能的需求碾压了非人工智能的所有需求；而专用存储增长相对而言是有限的，并没有因为专用存储的价格提升导致市场消费者买不起或者不买了。 问题 8：请教车规和工业芯片的景气度是怎样的？公司的当下相关的产能紧张程度如何？ 明年是否有产能瓶颈或产能释放的压力？ 回复：2022-2023 年行业在底部，但是从今年下半年开始，我们看到车规芯片的订单需求明显提升。从公司工业与汽车相关营收的占比来看，这个比值也是在增加的。公司有很多客户是做手机和消费类，但明显大家知道这一块的市场比较疲弱，这些客户也希望寻求成长，就开拓到工业和汽车领域。因此即便工业和汽车领域的整体需求在来年并没有明显的增加，但我们的客户在供应链的占比会增加，我们的产品和技术平台也准备好了与客户共同成长。 问题 9：公司四季度的销售收入指引为增长 4%-6%，能否拆分量价各自的贡献？往后看四季度和明年晶圆代工厂是否还有提价的空间？ 回复：四季度的量价可能各有一部分的贡献，价格增长的逐步落地也使得四季度的 ASP 有一定比例的增加。价格趋势方面，公司从来不是第一个在市场上提价的，我们不追求单一季度的指标，而是与客户共同做长期规划。具体的数字现在还不能定下来，还是要看整个行业和客户自己能够承受的程度。还有一个就是看我们供应链上面价钱波动情况，基本的材料、电费这些费用的成长，以及主要的工艺设备采购的价钱在提高，我们会慢

	慢的跟客户一起商量，大家要分担这部分的成长。 如需了解完整版业绩说明会，请在业绩发布一年内访问中芯国际官网收听完整版语音记录。
是否涉及应当披露重大信息的说明	沟通内容基于公司已公开披露信息。